



平成 22 年 11 月 8 日

各 位

会 社 名 松 田 産 業 株 式 会 社
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松 田 芳 明
(コード番号：7456 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 IR 部長 田 代 芳 孝
電 話 番 号 0 3 - 5 3 8 1 - 0 7 2 8

マレーシアにおける工場建設について

当社は、貴金属関連事業の拠点構築を目的にマレーシア現地法人 MATSUDA SANGYO (MALAYSIA) SDN. BHD. (以下、MSM) を設立し、工場建設の準備を行ってまいりましたが、このたび、建設に着手する運びとなりましたので、お知らせいたします。

1. 工場建設の理由

当社は、半導体・電子部品の製造拠点として成長を続けるマレーシアにおいて、マレーシア政府の環境政策に適合した半導体・電子部品の貴金属含有スクラップの回収・精錬工場の建設を計画してまいりました。このたび現地法人 MSM による工場建設が許可されたため、工場建設に着手するものであります。

2. 工場建設計画の概要

- (1) 所在地: マレーシア国セランゴール州ペタリング地区ハイコム工業団地
- (2) 敷地面積: 約 20,000 m²
- (3) 着工: 平成 22 年 11 月
- (4) 操業予定: 平成 23 年 9 月
- (5) 総投資額: 約 10 億円

3. 業績に与える影響

本件工場建設に伴う平成 23 年 3 月期の業績への影響は軽微であります。

(参考)現地法人 MSM の概要

- (1) 商号 MATSUDA SANGYO (MALAYSIA) SDN. BHD.
- (2) 代表者 西出 悌順
- (3) 設立年月日 平成 21 年 6 月 10 日
- (4) 資本金の額 15 百万マレーシアリングgit
- (5) 株主構成 当社 100%

以上